

2020-2026年中国半导体封测行业市场行情监测及 未来前景展望报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2020-2026年中国半导体封测行业市场行情监测及未来前景展望报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201911/810481.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

国内半导体自给率有提升空间。自2005年以来中国一直是集成电路最大的消费国，2018年中国的半导体市场规模达到2380亿美金，中国半导体市场占全球市场份额达到51%。但是中国半导体市场依赖进口，2018年晶圆代工产业自给率仅为21%，逻辑封测产业自给率为41%，存储封测产业自给率仅为9%，无晶圆设计产业自给率仅为自给率仅为32%，存储芯片产业自给率为1%，半导体设备产业自给率为14%。随着供应链安全重要性的提高，国内密集出台产业政策扶持半导体产业发展，未来半导体自给率有比较大的提升空间。

中国半导体产业自给率及预测（2017-2024年）

年份	2017	2018	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
中国晶圆代工产业自给率（%）	21%	21%	22%	23%	22%	23%	23%	25%
中国逻辑封测产业自给率（%）	39%	41%	41%	42%	43%	44%	45%	47%
中国存储封测产业自给率（%）	10%	9%	10%	12%	14%	16%	22%	22%
中国无晶圆设计产业自给率（%）	28%	32%	33%	35%	36%	38%	40%	42%
中国存储芯片产业自给率（%）	1%	1%	2%	4%	7%	11%	16%	17%
中国半导体设备产业自给率（%）	16%	14%	13%	14%	16%	17%	19%	18%

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国半导体封测行业市场行情监测及未来前景展望报告》共十二章。首先介绍了半导体封测行业市场发展环境、半导体封测整体运行态势等，接着分析了半导体封测行业市场运行的现状，然后介绍了半导体封测市场竞争格局。随后，报告对半导体封测做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体封测行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体封测产业有个系统的了解或者想投资半导体封测行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体封测行业相关基础概述

1.1 半导体封测的定义及分类

1.1.1 半导体封测的界定

1.1.2 半导体封测的分类

1.1.3 半导体封测的特性

1.2 半导体封测行业特点分析

1.2.1 市场特点分析

1.2.2 行业经济特性

1.2.3 行业发展周期分析

1.2.4 行业进入风险

1.2.5 行业成熟度分析

第二章 2015-2019年中国半导体封测行业市场发展环境分析

2.1 中国半导体封测行业经济环境分析

2.1.1 中国经济运行情况

1、国民经济运行情况GDP

2、消费价格指数CPI、PPI

3、全国居民收入情况

4、恩格尔系数

5、工业发展形势

6、固定资产投资情况

2.1.2 经济环境对行业的影响分析

2.2 中国半导体封测行业政策环境分析

2.2.1 行业监管环境

1、行业主管部门

2、行业监管体制

2.2.2 行业政策分析

1、主要法律法规

2、相关发展规划

2.2.3 政策环境对行业的影响分析

2.3 中国物流行业总体发展情况

2.3.1 物流总额情况分析

2.3.2 物流总费用情况分析

2.3.3 物流业增加值情况分析

2.3.4 物流固定资产投资分析

2.3.5 物流业景气情况分析

第三章 中国半导体封测行业上、下游产业链分析

3.1 半导体封测行业产业链概述

3.1.1 产业链定义

3.1.2 半导体封测行业产业链

3.2 半导体封测行业主要上游产业发展分析

3.2.1 上游产业发展现状

3.2.2 上游产业供给分析

3.2.3 上游供给价格分析

3.2.4 主要供给企业分析

3.3 半导体封测行业主要下游产业发展分析

3.3.1 下游产业发展现状

3.3.2 下游产业需求分析

3.3.3 下游主要需求企业分析

3.4 中国半导体封测行业业务量情况分析

3.4.1 半导体封测业务量走势

3.4.2 业务量产品结构分析

3.4.3 业务量区域结构分析

3.4.4 业务量企业结构分析

第四章 国际半导体封测行业市场发展分析

4.1 2015-2019年国际半导体封测行业发展现状

4.1.1 国际半导体封测行业发展现状

4.1.2 国际半导体封测行业发展规模

4.1.3 国际半导体封测主要技术水平

4.2 2015-2019年国际半导体封测市场研究

4.2.1 国际半导体封测市场特点

4.2.2 国际半导体封测市场结构

4.2.3 国际半导体封测市场规模

4.3 2015-2019年国际区域半导体封测行业研究

4.3.1 欧洲

4.3.2 美国

4.3.3 日韩

4.4 2020-2026年国际半导体封测行业发展展望

4.4.1 国际半导体封测行业发展趋势

4.4.2 国际半导体封测行业规模预测

4.4.3 国际半导体封测行业发展机会

第五章 2015-2019年中国半导体封测行业发展概述

5.1 中国半导体封测行业发展状况分析

5.1.1 中国半导体封测行业发展阶段

5.1.2 中国半导体封测行业发展总体概况

5.1.3 中国半导体封测行业发展特点分析

5.2 2015-2019年半导体封测行业发展现状

集成电路主要由设计、制造以及封测三大板块组成。2017年，中国集成电路这三块的营收占比分别为38.3%、26.8%、34.9%。相比世界IC产业三业合理占比3:4:3,我国封测行业占

比偏高，说明我国封测产业相对先进，而IC制造相比世界平均水平差距较大。封测行业市场份额高度集中，马太效应显现，并购提升行业集中度。2018年全球OSAT前十大厂商市占率超过80%，行业高度集中。因为OSAT与Foundry在产业链上紧密关联，依靠台积电在Foundry市场超过50%份额的垄断地位，台湾地区在OSAT市场也扮演着主导角色。2018年前十大OSAT厂商中，中国大陆/台湾地区共8家、美国1家以及新加坡1家。而随着半导体行业进入成熟期，市场竞争越发激烈，马太效应越发显著，导致近年行业并购频发，中国封测厂也通过并购迅速提升自身技术实力和规模。

2018年全球封测厂前十营收排名(百万美元)

数据来源：公开资料整理2014-2018年封测行业并购事件 2014-2018年封测行业并购事件公司 并购事件 力成 2017年收购MicronAkita 日月光 2017年收购矽品 安靠 2016年收购欧洲封测龙头Nanium 通富微电 2015年收购AMD苏州和槟州封测厂 长电科技 2014年收购全球第四大封测厂星科金朋 华天科技 2014年收购美国封测厂FCI

数据来源：公开资料整理

5.2.1 2015-2019年中国半导体封测行业发展热点

5.2.2 2015-2019年中国半导体封测行业发展现状

5.2.3 2015-2019年中国半导体封测企业发展分析

5.3 中国半导体封测行业细分市场概况

5.3.1 市场细分充分程度

5.3.2 细分市场结构分析

5.3.3 电商半导体封测市场

5.3.4 同城半导体封测服务市场

5.3.5 国际件半导体封测市场

5.4 中国半导体封测行业发展问题及对策建议

5.4.1 中国半导体封测行业发展制约因素

5.4.2 中国半导体封测行业存在问题分析

5.4.3 中国半导体封测行业发展对策建议

第六章 中国半导体封测行业运行指标分析及预测

6.1 中国半导体封测所属行业企业数量分析

6.1.1 2015-2019年中国半导体封测行业企业数量情况

6.1.2 2015-2019年中国半导体封测行业企业竞争结构

6.2 2015-2019年中国半导体封测所属行业财务指标总体分析

6.2.1 所属行业盈利能力分析

6.2.2 所属行业偿债能力分析

6.2.3 行业营运能力分析

6.2.4 行业发展能力分析

6.3 中国半导体封测行业市场规模分析及预测

6.3.1 2015-2019年中国半导体封测行业市场规模分析

6.3.2 2020-2026年中国半导体封测行业市场规模预测

6.4 中国半导体封测行业市场供需分析及预测

6.4.1 中国半导体封测行业市场供给分析

1、2015-2019年中国半导体封测行业供给规模分析

2、2020-2026年中国半导体封测行业供给规模预测

6.4.2 中国半导体封测行业市场需求分析

1、2015-2019年中国半导体封测行业需求规模分析

2、2020-2026年中国半导体封测行业需求规模预测

第七章 中国半导体封测行业市场竞争格局分析

7.1 中国半导体封测行业竞争格局分析

7.1.1 半导体封测行业区域分布格局

7.1.2 半导体封测行业企业规模格局

7.1.3 半导体封测行业企业性质格局

7.2 中国半导体封测行业竞争五力分析

7.2.1 半导体封测行业上游议价能力

7.2.2 半导体封测行业下游议价能力

7.2.3 半导体封测行业新进入者威胁

7.2.4 半导体封测行业替代产品威胁

7.2.5 半导体封测行业现有企业竞争

7.3 中国半导体封测行业竞争SWOT分析

7.3.1 半导体封测行业优势分析（S）

7.3.2 半导体封测行业劣势分析（W）

7.3.3 半导体封测行业机会分析（O）

7.3.4 半导体封测行业威胁分析（T）

7.4 中国半导体封测行业投资兼并重组整合分析

7.4.1 投资兼并重组现状

7.4.2 投资兼并重组案例

7.5 中国半导体封测行业竞争策略建议

第八章 中国半导体封测行业领先企业竞争力分析

8.1 长电科技

8.1.1 企业发展基本情况

8.1.2 企业主营业务分析

8.1.3 企业竞争优势分析

8.1.4 企业经营状况分析

8.1.5 企业最新发展动态

8.1.6 企业发展战略分析

8.2 星科金朋

8.2.1 企业发展基本情况

8.2.2 企业主营业务分析

8.2.3 企业竞争优势分析

8.2.4 企业经营状况分析

8.2.5 企业最新发展动态

8.2.6 企业发展战略分析

8.3 中芯国际

8.3.1 企业发展基本情况

8.3.2 企业主营业务分析

8.3.3 企业竞争优势分析

8.3.4 企业经营状况分析

8.3.5 企业最新发展动态

8.3.6 企业发展战略分析

8.4 日月光

8.4.1 企业发展基本情况

8.4.2 企业主营业务分析

8.4.3 企业竞争优势分析

8.4.4 企业经营状况分析

8.4.5 企业最新发展动态

8.4.6 企业发展战略分析

8.5 力成科技

8.5.1 企业发展基本情况

8.5.2 企业主营业务分析

8.5.3 企业竞争优势分析

8.5.4 企业经营状况分析

8.5.5 企业最新发展动态

8.5.6 企业发展战略分析

第九章 2020-2026年中国半导体封测行业发展趋势与投资机会研究

9.1 2020-2026年中国半导体封测行业市场发展潜力分析

9.1.1 中国半导体封测行业市场空间分析

9.1.2 中国半导体封测行业竞争格局变化

9.1.3 中国半导体封测行业互联网+前景

9.2 2020-2026年中国半导体封测行业发展趋势分析

9.2.1 中国半导体封测行业品牌格局趋势

9.2.2 中国半导体封测行业渠道分布趋势

9.2.3 中国半导体封测行业市场趋势分析

9.3 2020-2026年中国半导体封测行业投资机会与建议

9.3.1 中国半导体封测行业投资前景展望

9.3.2 中国半导体封测行业投资机会分析

9.3.3 中国半导体封测行业投资建议

第十章 2020-2026年中国半导体封测行业投资分析与风险规避

10.1 中国半导体封测行业关键成功要素分析

10.2 中国半导体封测行业投资壁垒分析

10.3 中国半导体封测行业投资风险与规避

10.3.1 宏观经济风险与规避

10.3.2 行业政策风险与规避

10.3.3 上游市场风险与规避

10.3.4 市场竞争风险与规避

10.3.5 技术风险分析与规避

10.3.6 下游需求风险与规避

10.4 中国半导体封测行业融资渠道与策略

10.4.1 半导体封测行业融资渠道分析

10.4.2 半导体封测行业融资策略分析

第十一章 2020-2026年中国半导体封测行业盈利模式与投资战略规划分析

11.1 国外半导体封测行业投资现状及经营模式分析

11.1.1 境外半导体封测行业成长情况调查

11.1.2 经营模式借鉴

11.1.3 国外投资新趋势动向

11.2 中国半导体封测行业商业模式探讨

11.2.1 行业主要商业模式

11.2.2 自建模式

11.2.3 特许加盟模式

11.2.4 代理模式

11.3 中国半导体封测行业投资发展战略规划

11.3.1 战略优势分析

11.3.2 战略机遇分析

11.3.3 战略规划目标

11.3.4 战略措施分析

11.4 最优投资路径设计

11.4.1 投资对象

11.4.2 投资模式

11.4.3 预期财务状况分析

11.4.4 风险资本退出方式

第十二章 研究结论及建议 (ZY LII)

12.1 研究结论

12.2 投资建议

12.2.1 行业发展策略建议

12.2.2 行业投资方向建议

12.2.3 行业投资方式建议 (ZY LII)

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201911/810481.html>